



山东汉芯科技有限公司

ShanDong HanXin Technology Co., Ltd

TEL:0632-7528601 FAX:0632-7528604

文件编号

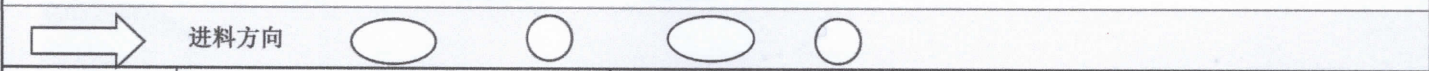
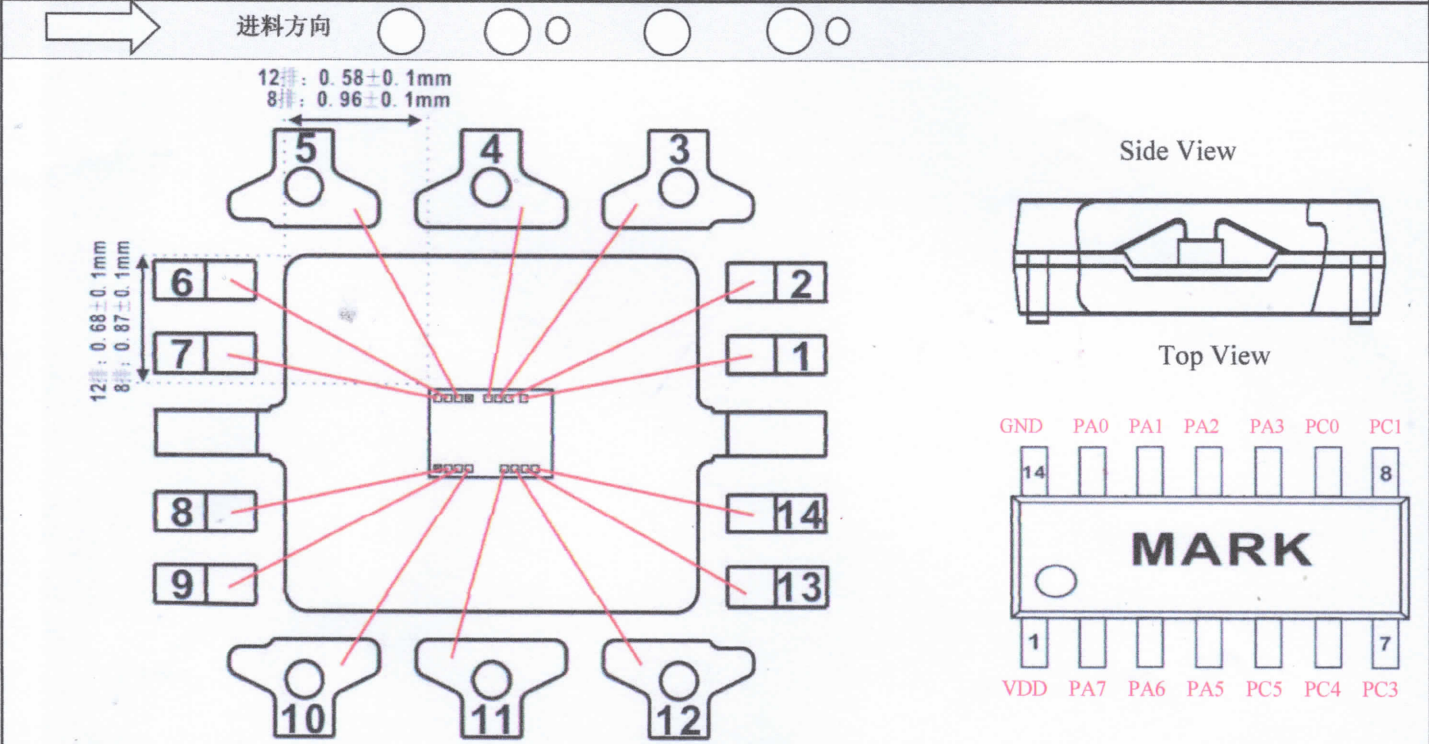
BD-HXQ73-SOP14004

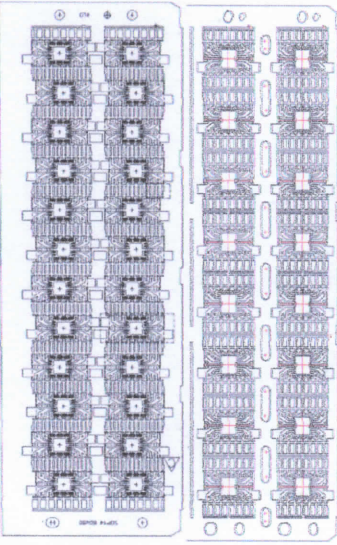
文件名称

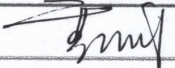
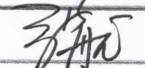
SOP14L 焊线图

芯片型号	HS6002	产品名称	HS16P2811	客户代码	HXQ73	版本	A
------	--------	------	-----------	------	-------	----	---

版本信息:			
版本	修改内容	修改日期	修改人
A	初版发行	2024-11-06	卢圣琼



项 目	参数信息	 <p>12排进料方向 8排进料方向</p>	<p>备注:</p> <p>PAD(焊盘)铝层厚度: 1.2um</p> <p>PAD 下方是否有敏感器件? <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无</p> <p>客户注意:</p> <p>焊接时, PAD 下方或附近有敏感器件时, 压焊会影响成品率和可靠性。</p> <p><input type="checkbox"/> 试产 <input type="checkbox"/> 直接量产 (直接量产我司不予保证良率)</p> <p>客户确认签字:</p>
划片道宽度	60um		
框架规格	12 排: $80 \times 80\text{mil}^2$ 8 排: $95 \times 110\text{mil}^2$		
粘胶型号	导电胶		
芯片尺寸	$835 \times 590\text{um}^2$ (不含划片道)		
芯片厚度	$260 \pm 10\text{um}$		
焊点尺寸	$49 \times 49\text{um}^2$		
焊点间距	NA		
焊线根数	14 根		
焊线总长	NA		
焊线线径	合金线/20um		

制定	卢圣琼	审核		批准	
制定日期	2024-11-06	审核日期	2024.11.08	批准日期	2024.11.08